

東京会場 須藤 行き FAX 03-6280-0073
名古屋会場 石井 行き FAX 052-936-6165
大阪会場 松本 行き FAX 06-6871-8470

エスアイアイ・ナノテクノロジー 熱分析・粘弾性スクールお申込用紙

* ご希望日程の□にチェックを入れてください。

- 2008年05月23日(金) 熱分析スクール 名古屋会場
- 2008年06月05日(木) 粘弾性スクール 大阪会場
- 2008年06月06日(金) 熱分析スクール 大阪会場
- 2008年06月19日(木) 粘弾性スクール 東京会場
- 2008年06月20日(金) 熱分析スクール 東京会場

* 参加費

一般	粘弾性	¥5,000(税込み)	*テキスト代含む
	熱分析	¥8,000(税込み)	*テキスト、昼食代含む
学生	粘弾性	¥2,000(税込み)	*テキスト代含む
	熱分析	¥3,000(税込み)	*テキスト、昼食代含む

ご勤務先	
ご所属	
ふりがな	
ご芳名	
ご住所	〒 -
TEL	
FAX	
E-mail	

アンケート

1. 現在装置を使っている はい いいえ
2. ご使用中の装置は DSC TGA または TG/DTA TMA DMA
3. 装置のメーカーは SII ナノテク その他()
4. 装置購入予定は あり(□1年以内 □2年以降) なし 未定
5. 今後、スクール/セミナー等の案内を希望されますか？

配信不要

* ご記入いただきましたお客様の個人情報については、当社へのお問合せ内容への回答、当社取扱製品/サービスに関するご案内、ご希望の各種資料の発送の目的においてのみ使用いたします。